

製品仕様書
PRODUCT
SPECIFICATION

***8071*Series**
MULTI LINE MODULE CONNECTOR

京セラ株式会社
KYOCERA Corporation

E	DCN21724	2022/02/09	T. Otani	H. Tamai	M. Yoshida
D	DCN18589	2018/06/29	R. Arai	H. Tamai	M. Yoshida
O	EDN-1190	2004/11/08	M. Yoshida	Y. Shiroyama	N. Hayashi
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

1. 品名 MULTI LINE MODULE CONNECTOR

2. 形式 MULTI LINE MODULE CONNECTOR

3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 8071 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 8071 Series MULTI MODULE CONNECTOR

4. 関連規格 Related documentation

- ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクタ試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧
Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-
Part 1-100: General-Applicable publications
- ・JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクタ試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧
Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-
Part 1-100: General-Applicable publications
- ・JIS-C-5402:1992 電子機器用コネクタの試験法
Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.

5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material

図面参照 Refer to drawings.

6. 製品型番 Part numbering

名称 DESCRIPTION	型番 PART NO	注記 NOTE
プラグ ST プレスフィットタイプ Plug ST PF CONNECTOR	*1) *2) *3) 17 8071 XXX XXX XXX +	*1)極数 Variation No. of contact
プラグシュラウド Plug SHROUD	*1) *2) 61 8071 XXX XXX 007	*2)バリエーション Variation *3)めっき仕様
リセプタクル RA プレスフィットタイプ REC RA PF CONNECTOR	*1) *2) *3) *4) 27 8071 XXX XXX 835 X +	Finish code *4)サフィックス Suffix

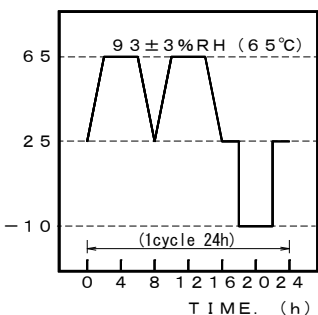
仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件・方法 Condition	規格 Specification
7.一般 General	1	定格電流 Current rating	—	DC 1A/contact (全シグナルコンタクト通電状態) (ALL SIGNAL CONTACTS LOADING)
	2	定格電圧 Voltage rating	—	DC 250V/contact
	3	使用温湿度範囲 Operation environment	—	−55℃ ～ 125℃ 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 Humidity: 90 % MAX. Ice-free at the low temperature No condensation shall occur
	4	保存温湿度範囲 Storage Environment	—	−10℃ ～ 60℃ 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 Humidity: 90 % MAX. Ice-free at the low temperature No condensation shall occur
	5	適合基板厚 Applicable board thickness		t=1.4～4.8 mm
			*スルーホール仕様 APPLICATION THROUGH HOLE	
銅スルーホール Copper through hole			はんだスルーホール (鉛フリー) SOLDER THROUGH HOLE (Pb-FREE)	
下穴径 Prepared hole DIA			φ 0.7 ±0.025	
銅めっき厚 Copper plating thickness			25～50 μ m	
	はんだめっき厚 Solder plating thickness		7.6 μ m MIN.	
	仕上径 Finished DIA	φ 0.6 ±0.05	φ 0.6 ^{+0.05} _{-0.1}	
8.機械的 Mechanical	1	外観 Appearance	目視 Visual Inspection	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形等のないこと。 No rust, contamination, damage or deformation effecting on function
	2	単一コンタクト抜去力 Individual contact separation force	適合する規定のゲージ若しくはプラグコンタクトを用いて測定を行う。	0.15 N MIN.(15 gf MIN.)
	3	総合嵌合・離脱力 Total insertion and separation force	100 mm/min.	嵌合力 Insertion force 0.75 N x n MAX.(76 gf x n MAX.) 離脱力 Separation force 0.15 N x n MIN. (15 gf x n MIN.)

	4	コンタクト保持力 Contact Retention Force	25mm/min.	プラグ Plug 4.9 N MIN.(0.5 kgf MIN.) リセ Rec 9.8 N MIN.(1.0 kgf MIN.)										
	5	プレスフィットポスト 基板挿入力 Press Fit post insertion force	7-5 項に規定された基板を使用し 挿入力を測定する。 Insertion force shall be measured with the board specified in paragraph 7-5.	156.8 N MAX.(16 kgf MAX.)										
	6	プレスフィットポスト 基板保持力 Press Fit post retention force	7-5 項に規定された基板を使用し 保持力を測定する。 Retention force shall be measured with the board Specified in paragraph 7-5.	9.8 N MIN.(1.0 kgf MIN.)										
	7	シュラウド挿入力 Shroud insertion force to post contact	プレスフィットポストに対するシュラウドの保持力を測定する。 Shroud insertion force should be measured.	294.1 N MAX.(30.0 kgf MAX.)										
	8	シュラウド保持力 Shroud retention force to post contact	プレスフィットポストに対するシュラウドの保持力を測定する。 Shroud insertion force should be measured.	29.4 N MIN.(3.0 kgf MIN.)										
	9	コーディングキー挿入力 Coding key insertion force to connector	コネクタに対するコーディングキーの挿入力を測定する。 Coding key insertion force should be measured.	49 N MAX.(5 kgf MAX.)										
	10	コーディングキー保持力 Coding key retention force connector	コネクタに対するコーディングキーの挿入力を測定する。 Coding key insertion force should be measured.	4.9 N MIN.(0.5 kgf MIN.)										
9.物理的性能 Physical performance	1	挿抜耐久性 Durability	無通電状態で 10 回/分 以下の 速さ without Current applied 10 times/min. N times	外観 Appearance 著しい腐食が生じないこと。 No evident corrosion. 接触抵抗 Contact Resistance 初期値からの変化量 Variation from initial value. 5 mΩ MAX										
			<table><tr><td>レベル LEVEL</td><td>めっき仕様 PLATING</td><td>挿抜回数(N) OPERATION(N)</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td>Pd/Ni 0.65 μm Au 0.76 μm</td><td rowspan="2">500</td></tr><tr><td>Pd/Ni 0.40 μm Au 0.03 μm</td></tr><tr><td>2</td><td>Au 0.38 μm</td><td>250</td></tr><tr><td>3</td><td>Au 0.1 μm</td><td>50</td></tr></table>		レベル LEVEL	めっき仕様 PLATING	挿抜回数(N) OPERATION(N)	1	Pd/Ni 0.65 μm Au 0.76 μm	500	Pd/Ni 0.40 μm Au 0.03 μm	2	Au 0.38 μm	250
レベル LEVEL	めっき仕様 PLATING	挿抜回数(N) OPERATION(N)												
1	Pd/Ni 0.65 μm Au 0.76 μm	500												
	Pd/Ni 0.40 μm Au 0.03 μm													
2	Au 0.38 μm	250												
3	Au 0.1 μm	50												

	2	振動 Vibration	10~55~500 Hz/15 min ／1.5mm (peak to peak) ／DC 100mA (2h per direction; XYZ, 6h in total)/10G IEC 60068-2-6:1995 JIS C 60068-2-6:1999	瞬断 Discontinuity 1 μ s MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack. 接触抵抗 Contact Resistance 初期値からの変化量 Variation from initial value. 5 m Ω MAX
	3	衝撃 Shock	50 G / 11 ms ／DC 100mA (3times per direction; XYZ) IEC 60068-2-27:1972 JIS C 60068-2-27:1995	瞬断 Discontinuity 1 μ s MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack
10.電氣的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC750 V、1 min (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992	フラッシュオーバー、スパークオーバー、 絶縁破壊ないこと。 No Flashover, spark over dielectric breakdown
	2	絶縁抵抗 Insulation resistance	DC100 V、1min JIS C 5402 (5.2):1992	初期:Initial 10 ⁴ M Ω MIN. 試験後:After test 10 ³ M Ω MIN.
	3	ローレベル接触抵抗 Low level contact resistance	四端子法にて Four prove method JIS C 5402(5.3):1992	初期:Initial 20 m Ω MAX. 試験後:初期値からの変化量 Variation from initial value. 5 m Ω MAX
	4	温度上昇 Temperature rise	嵌合状態でコンタクトを直列に 結線 Under mating condition, all contacts shall be connected serially. JIS C 5402 (5.10):1992	定格電流にて 30K MAX. at the Current rating

11.耐環境 Environment	1	二酸化硫黄 SO ₂	40±2℃ / 75% / 10±1ppm / 96h IEC 60068-2-42:1982 JIS C 60068-2-42:1993	接触抵抗 Contact Resistance : 初期値からの変化量 Variation from initial value. 5 mΩ MAX															
	2	温度サイクル Temperature cycling	5 cycles (Modified) IEC 60068-2-14:1984、 -33:1971 JIS C 0025:1988	接触抵抗 Contact Resistance : 初期値からの変化量 Variation from initial value. 5 mΩ MAX															
			<table><tr><td>段階 Step</td><td>温度(℃) Temperature</td><td>時間(分) Time(min.)</td></tr><tr><td>1</td><td>-55±3</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>25 ⁺¹⁰₋₅</td><td>5 MAX.</td></tr><tr><td>3</td><td>105±2</td><td>30</td></tr><tr><td>4</td><td>25 ⁺¹⁰₋₅</td><td>5 MAX.</td></tr></table>	段階 Step	温度(℃) Temperature	時間(分) Time(min.)	1	-55±3	30	2	25 ⁺¹⁰ ₋₅	5 MAX.	3	105±2	30	4	25 ⁺¹⁰ ₋₅	5 MAX.	プレスフィットポスト保持力 Press Fit post retention force : 9.8 N MIN.(1.0 kgf MIN.)
			段階 Step	温度(℃) Temperature	時間(分) Time(min.)														
			1	-55±3	30														
2			25 ⁺¹⁰ ₋₅	5 MAX.															
3	105±2	30																	
4	25 ⁺¹⁰ ₋₅	5 MAX.																	
3	温湿度サイクル Temperature and humidity cycling	10 Cycle / 65℃ / 93±3% IEC 60068-2-38:1974 JIS C 60068-2-38:1988 	接触抵抗 Contact Resistance : 初期値からの変化量 Variation from initial value. 5 mΩ MAX 絶縁抵抗 Insulation resistance 10 ³ MΩ MIN. 耐電圧 Dielectric withstanding voltage フラッシュオーバー、スパークオーバー 絶縁破壊ないこと。 No Flashover, spark over, dielectric breakdown																
4	高温加速(寿命) High temperature(Life)	85±2℃ / 96h IEC 60068-2-2:1974 JIS C 60068-2-2:1995	接触抵抗 Contact Resistance : 初期値からの変化量 Variation from initial value. 5 mΩ MAX 単一コンタクト抜去力: 0.15 N MIN.(15 gf MIN.) プレスフィットポスト保持力 Press Fit post retention force 9.8 N MIN.(1.0 kgf MIN.)																

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

- (1) 本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2) 本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。

If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.

- (3) 以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の条件が加わった事が証明された場合。

If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.

2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛 Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.